

名古屋大学 最先端半導体レクチャー 2026 年度 春学期

主催: 名古屋大学 最先端半導体研究戦略室

共催: 名古屋大学大学院 工学研究科、東海地域半導体実践人材育成拠点 (予定)

協賛: UPWARDS for the Future

日本国内では世界の半導体産業を支える様々な材料・製造装置・デバイス関連企業が活動しています。これら企業の技術者、研究者から、最先端半導体工学および関連産業について学べる年間全 16 回の講演会を開催します。「UPWARDS for the Future*」、「中部地域半導体人材育成等連絡協議会**」、「東海地域半導体実践人材育成拠点***」の各参画企業などから提供される講演を自由に選んで参加できます。講演終了後、講師の方々と交流できる「懇話会」も開催します。半導体業界の最新状況を知り、半導体および関連産業を多角的に捉えて、将来を考えるとともに、関係者との交流も広げられる貴重な機会です。皆様ふるってご参加下さい。

- ・日時: 2026 年度通年 (春・秋学期) 金曜日[不定期開催] 第 4 限 (14:30 開場、14:45～16:15 講演。日付はスケジュール表を参照。講演後、懇話会を開催します)
- ・会場: EI 創発工学館・3 階東・TEL オーディトリウム、一部ハイブリッドも予定
- ・対象: 名古屋大学の大学院生、学部学生、教職員。
- ・参加方法 (無料): 参加希望者は、随時、下記 URL または右記 QR コードからつながる機構 Forms から事前登録して下さい。開催・関連情報などを TACT から提供します。講演会当日に会場へ来訪下さい。

<https://forms.office.com/r/ufbiuP7qcq>

※アクセス、登録には機構アカウントへのサインインが必要です。

- ・春学期スケジュール (※参加登録して最新情報を確認下さい)

開催日時	講演題目 (仮・予定を含む)	講師・所属 (一部検討中)
4 月 10 日 (金) 14:45～	半導体が拓く未来 ～エレクトロニクス・半導体産業の動向～	井関 裕二、朝羽 俊介・電子情報技術産業協会 (JEITA)
4 月 24 日 (金) 14:45～	アナログファウンドリ事業と技術開発	佐藤 直昭・タワーパートナーズセミコンダクター(株)
5 月 8 日 (金) 14:45～	自動車の進化を支える車載半導体	松ヶ谷 和沖・(株)デンソー
5 月 22 日 (金) 14:45～	先進半導体の配線技術およびパッケージ技術	松永 範昭・アプライド・マテリアルズ
6 月 5 日 (金) 14:45～	先端 NAND デバイスにおける metalization process 技術	寺澤 佑仁・サンディスク合同会社
6 月 19 日 (金) 14:45～	TSMC Advanced Technology Design Platform with AI	TSMC Design Technology Japan, Inc.
7 月 3 日 (金) 14:45～	検討中	(株)SCREEN セミコンダクターソリューションズ
7 月 17 日 (金) 14:45～	半導体メモリ	マイクロンテクノロジー

※各回、レクチャー終了後、「最先端半導体懇話会」を開催します (喫茶軽食を提供予定)。

レクチャー聴講者は無料で参加できます。多数の皆様の参加を歓迎します。

* UPWARDS for the Future <https://www.upwardsforthefuture.com/>

**中部地域半導体人材育成等連絡協議会 <https://www.chubu.meti.go.jp/c31seizo/semicon/index.html>

***東海地域半導体実践人材育成拠点 <https://tokai-semicon.jp/>



・秋学期スケジュール（暫定版）

春学期時点の参加登録者には、秋学期も継続して開催案内を配信予定です。

開催日時	講演題目（仮・予定を含む）	講師・所属（一部検討中）
10月9日（金） 14:45～	半導体製造を支えるプラズマエッチングの技術と人財	大矢 欣伸・東京エレクトロン宮城（株）
10月23日（金） 14:45～	検討中	ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン（株）
11月6日（金） 14:45～	AIを活用した半導体集積回路の先端設計技術	深澤浩公・ヌヴォトン テクノロジージャパン（株）
11月20日（金） 14:45～	検討中	岩崎 晃久・Rapidus（株）
12月4日（金） 14:45～	半導体パッケージ基板の進化と今後の技術動向	瀬川 博史・イビデン（株）
12月18日（金） 14:45～	NAND Flash Memory とキオクシア	キオクシア（株）
1月8日（金） 14:45～	SiC パワーモジュールの技術動向と研究事例、など	東芝デバイス&ストレージ（株）
1月22日（金） 14:45～	TBD	TBD